

BGA/CSP 用ハンダボール

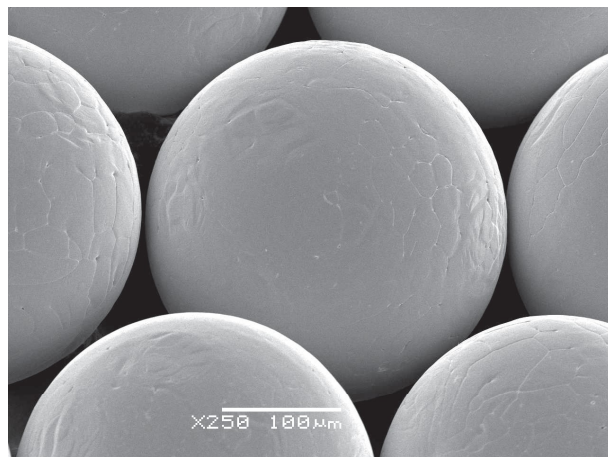
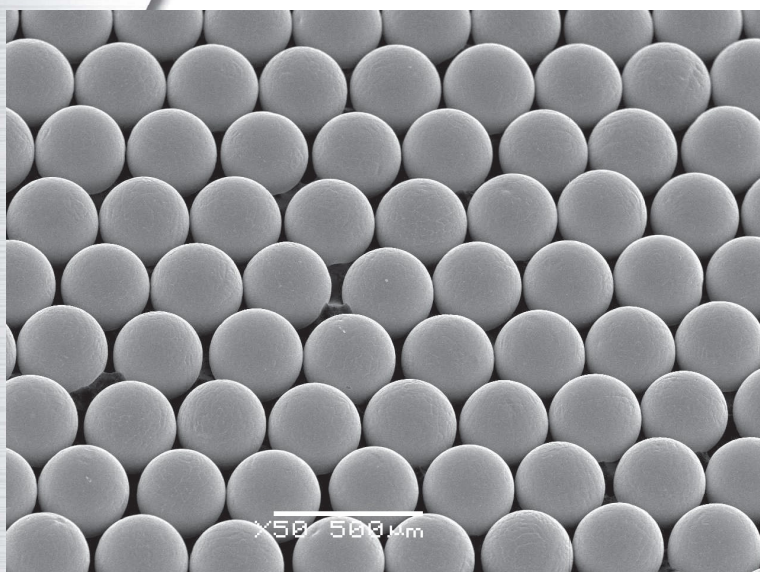
Lead Free Solder Ball for BGA,CSP

Pb フリーハンダボール

Lead Free Solder Ball

特長 Advantages

真球度に優れ、表面酸化が少ないです。
High sphericity and less surface oxidation



粒径 Diameter	公差 Tolerance
80~300µm	±10µm
350~450µm	±10µm
500~760µm	±20µm

品番 Grade	組成 Composition (mass%)					熔融温度 Melting Temp. (°C)	比重 Specific Gravity (g/cm ³)
	Sn	Ag	Cu	Bi	Au		
FBM-Sn3.5Ag	Bal	3.5				221	7.36
FBM-Sn3Ag0.5Cu	Bal	3	0.5			217-219	7.4
FBM-Sn58Bi	Bal			58		139	8.7
FBM-SN100C *1	*2					*3	*4
FBM-Au20Sn	Bal				20	280	14.52
FBM-Au90Sn	Bal				90	217	7.78

※1 SN100C (SnCu系) : 株式会社日本スぺリア社の品名 Product name of NIHON SUPERIOR

※2,3,4 SN100Cの仕様に準ずる Conforming to spec of SN100C

※上記以外の組成、粒径、公差につきましてはご相談下さい。

Please ask us to manufacture for the other compositions,particle diameter and tolerance.

※品番によって対応可能な粒径が異なります。詳細につきましてはご相談下さい。

The particle diameter which we can manufacture depends on Grade. Please ask us detail.



FUKUDA
FUKUDA METAL FOIL & POWDER CO.,LTD.
福田金属箔粉工業株式会社



福田金属箔粉工業株式会社 HP



UDS 製品紹介 HP